

安全・法律に関する遵守事項

製品仕様・製品用途

- 本製品および製品仕様は改良のために予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。したがって、最終的な設計、ご購入、ご使用に際しましては用途の如何にかかわらず、事前に、仕様を詳細に説明している最新の納入仕様書を請求され、ご確認ください。また、当社納入仕様書の記載内容を逸脱して本製品をご使用にならないでください。
- 本製品は、本カタログもしくは納入仕様書に個別に記載されている場合を除き、一般電子機器（AV機器、家電製品、業務用機器、事務機器、情報、通信機器など）に標準的な用途で使用されることを意図しています。本製品を、特別な品質・信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある用途（例：宇宙・航空機器、運輸・交通機器、燃焼機器、医療機器、防災・防犯機器、安全装置など）にお使いになる場合は、別途、用途に合った納入仕様書を、当社と取り交わしてください。

安全設計・製品評価

- 当社製品の不具合によって、人命の危機、その他の重大な損害が発生しないよう、お客様側のシステム設計において保護回路や冗長回路等により安全性を確保してください。
- 本カタログは部品単体での品質・性能を示すものです。使用環境、使用条件によって耐久性が異なりますので、ご使用に際しては必ず貴社製品に実装された状態および実際の使用環境でご評価、ご確認ください。当製品の安全性について疑義が生じたときは、速やかに当社へご通知いただくと共に、貴社にて必ず、上記保護回路や冗長回路等を含む技術検討を行ってください。

法律・規制・知的財産

- 本製品は、国連番号、国連分類などで定められた輸送上の危険物ではありません。また、このカタログに記載されている製品・製品仕様・技術情報を輸出する場合は、輸出国における法令、特に安全保障輸出管理に関する法令を遵守してください。
- 本製品は、RoHS（電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する）指令（2011 / 65 / EU 及び（EU）2015 / 863）に対応しております。製品により、RoHS指令/REACH規則対応時期は異なります。また、在庫品をご使用の場合で、RoHS指令/REACH規則対応可否が不明の場合は、お問合せフォームより「営業的お問合せ」を選択してご連絡ください。
- 使用する部材の製造工程並びに本製品の製造工程において、モントリオール議定書に規程されているオゾン層破壊物質や、PBBs (Poly-Brominated Biphenyls) / PBDEs (Poly-Brominated Diphenyl Ethers) のような特定臭素系難燃剤は意図的には使用しておりません。また、本製品の使用材料は、“化学物質の審査及び構造等の規制に関する法律”に基づき、すべて既存の化学物質として記載されている材料です。
- 本製品の廃棄に関しては、本製品が貴社製品に組み込まれて使用されるそれぞれの国、地域での廃棄方法を確認してください。
- このカタログに記載されている技術情報は、製品の代表的動作・応用回路例などを示したものであり、当社もしくは第三者の知的財産権を侵害していないことの保証または実施権の許諾を意味するものではありません。

本カタログの記載内容を逸脱または遵守せず、当社製品を使用された場合、弊社は一切責任を負いません。ご了承ください。

ご使用にあたっての遵守事項

(プレッシャセンサ / PS-A)

使用環境・洗浄条件

- 空気以外の媒体、特に腐食系ガス（有機溶剤系ガス、亜硫酸系ガス、硫化水素系ガスなど）や水分・異物を含む媒体で使用、保管しないでください。また、極微量の媒体が漏洩し、周囲の環境や人体に影響を及ぼす可能性があるため、腐食性ガス、可燃性ガス、有害ガスなどの媒体で使用しないでください。
- 防滴構造ではありませんので、水などがかかる可能性のある場所、結露する環境では使用しないでください。製品に付着した水分が凍結した場合、出力の変動または破壊が起こることがあります。
- 本製品は構造的に光が当たると出力が変動します。特に透明チューブなどで圧力を印加する際は、光が当たらないようにしてください。
- 超音波など高周波の振動が加わる使用はしないでください。
- 静電気やカミナリ、携帯電話、アマチュア無線、放送局などの電氣的雑音によって誤動作する場合があります。
- 本製品は大気と開放していますので、洗浄液が内部に入らないようご注意ください。また、故障に至る可能性がありますので、超音波を使用した洗浄はしないでください。

取扱条件

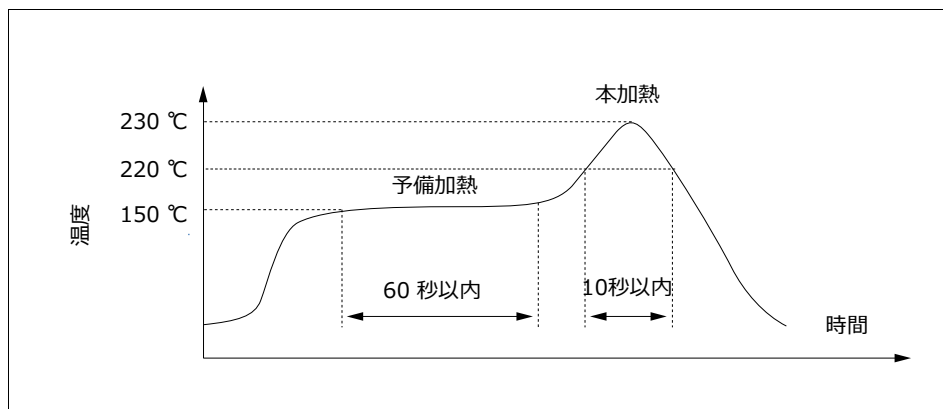
- 定格圧力の範囲内でご使用ください。範囲外の使用は事故、破損の原因となります。また、使用する圧力により、製品の固定およびチューブ、導入口などの固定、選択をしてください。ご不明な点はお問い合わせください。
- 圧力導入口の内部にはセンサチップが配置されています。圧力導入口から針金などの異物を挿入すると、チップ破損や導入口の目づまりの原因となりますので絶対にしないでください。また、導入口をふさがないでください。
- 本製品を実装した基板をコーティングする場合は、ポッティング剤などが「圧力導入口」および「大気圧導入口」に入らないようにしてください。また、熱によりコーティングした樹脂が膨張・収縮するとセンサに応力がかかりますので、弾力性のある樹脂を十分に評価した上でご使用ください。
- 静電気によって破壊することがありますので、保存には導電性の材料で端子間を短絡するか、全体をアルミホイルなどで包んでください。プラスチック系の容器は帯電しやすいため、保存、運搬には使用しないでください。また、使用にあたっては、周囲の静電気を安全に放電させるように机上の帯電物、作業者を接地してください。

回路設計・基板設計

- 結線は端子接続図の通り正確に行ってください。また、製品の破損や劣化が起こりますので、電源の逆接続や空き端子の結線はしないでください。
- 耐電源重畳ノイズ性を確保するため、本製品の電源入力端子には必ずコンデンサを設け、電源電圧の安定化を図りご使用ください。推奨として0.1 μF と1,000 pF を並列に設けることをお勧めいたします。ただし、実機上での耐ノイズ性を確認の上、最適なコンデンサの選定・追加をしてください。
- 外部サージ電圧が加わりますと内部回路が破損しますのでサージ吸収素子をご使用ください。
- 本製品が十分に固定できるようなプリント基板ランドをご採用ください。

実装条件

- 本製品は熱容量の小さい小型構造のため、はんだ付けに際しては、外部から熱の影響をできる限り少なくするようにしてください。熱変形による破損、特性変動の恐れがあります。
- フラックスは非腐食性のロジン系をご使用ください。また、本製品は大気と開放していますので、フラックスが内部に入らないようにしてください。
- 手はんだの場合は、はんだこて先のクリーニングを十分に行った上で、こて先端温度260～300℃(30W)で5秒以内に実施ください。また、出力が変化する恐れがありますので、端子に負荷をかけないでください。
- フローはんだ(DIP端子タイプ)の場合、フローはんだ槽温度260℃以下で5秒以内に実施ください。熱容量の小さい基板上に実装する場合は熱変形する恐れがありますので、フローはんだは使用しないでください。
- リフローはんだ(SMD端子タイプ)の場合、クリームはんだの印刷方式は、スクリーンはんだ印刷方式をお勧めします。
- プリント基板フットパターンは、プリント基板推奨仕様図をご参考ください。また、セルフアライメントが不十分な場合がありますので、本製品の端子とパターンの位置あわせは慎重に行ってください。
- 推奨リフロー温度プロファイル条件を下図に示します。プロファイルの温度は、端子部近傍のプリント基板で測定した値と致します。



- 装置や条件により圧力導入口の先端が高温によって溶解や変形する場合がありますので、必ず実際の実装条件で確認テストを実施してください。
- はんだ付け部のリワークは、一度でお済ましてください。はんだブリッジのリワークの際はコテ先形状の平らなコテを使い、フラックスの追加塗布をしないでください。はんだコテ先温度は、仕様書記載温度以下のコテをご使用ください。
- プリント基板のそりにより本製品に応力が加わり特性が変化する場合がありますので、はんだ付け後の特性確認テストを実施してください。また、本製品の实装後に基板の切り折りをを行う際は、はんだ部に応力が発生しないようにしてください。
- 本製品は端子が露出する構造ですので、金属片等が端子に触れると出力の異常を引き起こします。金属片や手などが触れることがないようにしてください。また、端子に過度の力が加わると変形し、はんだ性が損なわれますので、製品の落下や煩雑な取り扱いを行わないでください。
- はんだ付け後、基板の絶縁劣化を防止するためコーティングを実施する際、本製品に薬剤が付着しないようにしてください。